

## 808nm 水平阵列 ( 硬焊料封装 )

### 产品简介

半导体激光器硬焊料封装水平阵列，可实现准连续高功率输出，产品多用于激光泵浦、激光切割、激光医疗等领域。

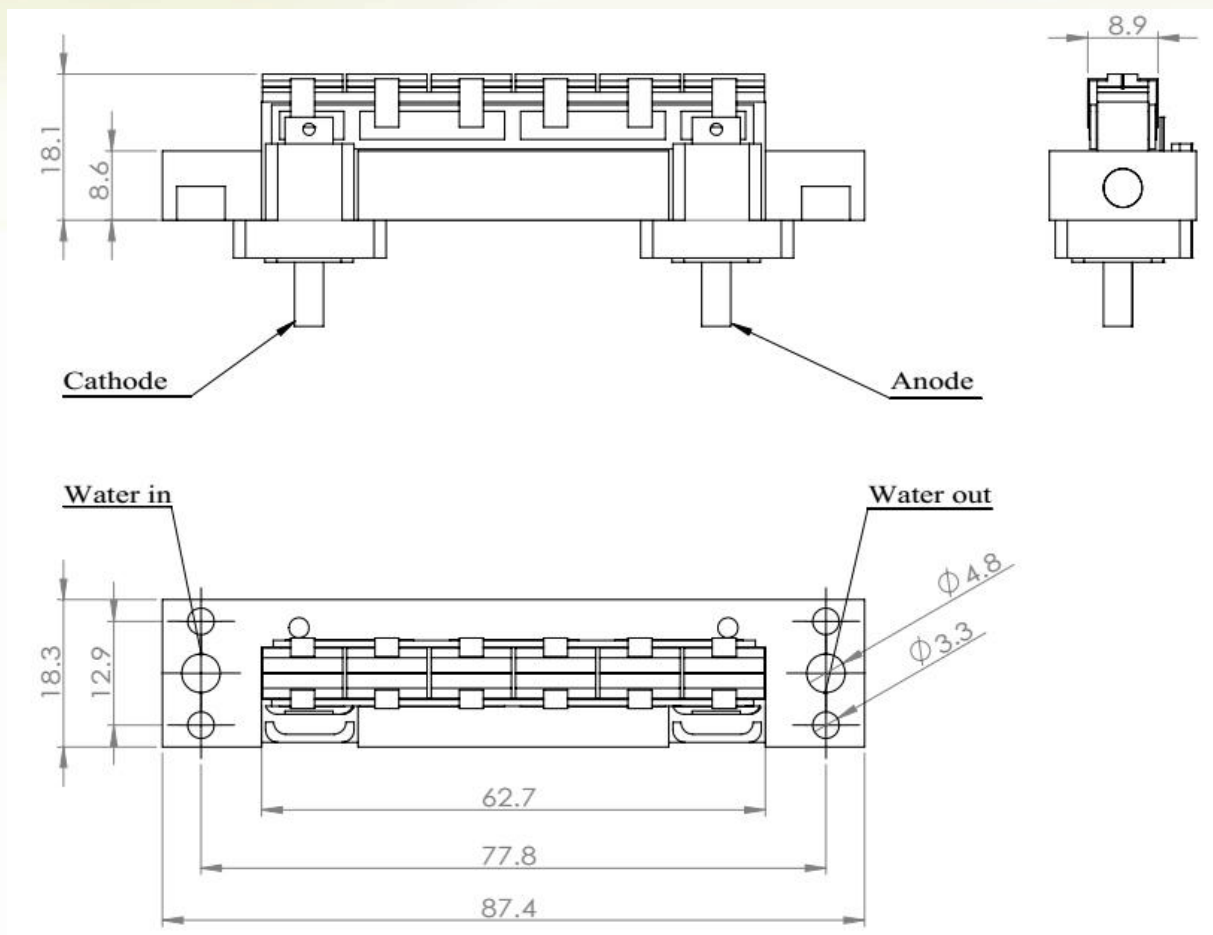


### 技术指标 ( 25°C )

水平阵列 ( 硬焊料封装 )			
参 数		单 位	LDAQ3-0808-****
光学参数	工作方式	-	QCW
	中心波长	nm	808 ± 5
	输出功率/Bar	W	150
	Bar 数量	条	3 ~ 9
	Bar 间距	mm	
	光谱宽度	nm	< 5
	温漂系数	nm/°C	0.28
	快轴发散角	deg	< 35
	慢轴发散角	deg	< 10
	占空比	%	≤ 3
电学参数	阈值电流	A	< 25
	工作电流	A	< 170
	工作电压/Bar	V	< 2.2
热学参数	推荐工作温度	°C	15 ~ 35
	存储温度	°C	-10 ~ 60



## 封装外形图



- 1、产品型号说明：LDAQ3 (产品类型) -0808 (中心波长) -\*\*\*\* (输出功率)。
- 2、封装外形图仅供参考，可依据客户提供图纸进行封装。
- 3、请确保激光器工作在 15 ~ 35°C。在较高温度下工作，会增大阈值电流，降低转换效率，加速器件老化。
- 4、请在设计和使用过程中采取防结露措施，避免结露，结露将导致激光器迅速退化。
- 5、如有更多信息需求请联系海特光电有限责任公司。

